

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ASMPT enabling the
digital world

ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

二零二三年第一季度業績新聞稿

有關 ASMPT Limited 及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止三個月業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：盧鈺霖先生及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)



ASMPPT 公布二零二三年第一季度業績

宏觀環境儘管充滿挑戰 二零二三年第一季度銷售收入依然高於預測之中位數

集團業績概覽

二零二三年第一季度財務概要

- * 銷售收入為港幣 39.2 億元(5.00 億美元)，按年-25.6%，按季亦-9.5%
- * 新增訂單總額為港幣 35.5 億元(4.53 億美元)，按年-49.7%，按季則+13.8%
- * 毛利率為 40.4%，按年-21 點子，按季亦-98 點子
- * 經營利潤率為 11.9%，按年-717 點子，按季亦-181 點子
- * 盈利為港幣 3.15 億元，按年-62.0%，按季則+18.2%
- * 每股基本盈利為港幣 0.77 元，按年-61.9%，按季則+18.5%

二零二三年第二季度銷售收入預測

- * 將介乎 4.55 億美元至 5.25 億美元之間，以其中位數計按年-26.2%，按季亦-2.0%

詳盡業績公布及投資者簡報可見於

<https://www.asmppt.com/zh-tw/investors/financials-results/>

(二零二三年四月二十六日，香港訊) — ASMPPT Limited (「ASMPPT」/「集團」/「本公司」)(股份代號：0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬件和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二三年三月三十一日止三個月之季度業績。集團的銷售收入高於預測之中位數。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「二零二三年第一季度宏觀經濟環境依然充滿挑戰，但綜合考慮各種因素，我們表現相對較好。集團受惠於自身獨特兼廣泛的產品組合，擁有多元化業務模式，為集團帶來業務韌性及競爭優勢，以及抵禦各種市場週期的能力。在艱難的營商環境中，集團的新增訂單總額、盈利及每股盈利皆錄得按季增長，毛利率亦保持穩健。雖然短期展望仍然不確定，但我們對較長期的復甦和增長前景依然充滿信心。」

二零二三年第一季度集團財務回顧

- 二零二三年第一季度的銷售收入為港幣 39.2 億元 (5.00 億美元)，SMT 業務佔集團總銷售收入的比例已連續三個季度高於 SEMI 業務。
- 新增訂單總額較二零二二年第四季度增加約 14%，主要受汽車終端市場的持續需求所推動。由於電子產品於汽車中的使用日漸增加，集團的解決方案，包括燒結、激光切割及塑封成型受到青睞，其汽車業務亦受惠於為全球更多電動車企業提供的解決方案。
- 毛利率已連續八個季度高於 40%，突顯集團在不同行業周期仍能維持平穩的毛利率。
- 經營利潤率為 11.9%，按季減少 181 點子，主要由於銷售減少所致。然而，盈利為港幣 3.15 億元，增加 18.2%，是基於二零二二年第四季度盈利受不利的外匯影響。
- 集團維持穩健的流動資金狀況，現金及銀行存款總額為港幣 39.9 億元。隨著銀行借貸減少至港幣 20 億元，現金及銀行存款淨額維持在港幣 19.9 億元的穩健水平。

SMT 表現強健

SMT 的銷售收入繼續表現強勁，佔集團二零二三年第一季度的總銷售收入 60.7%，於二零二三年第一季度新增訂單總額按季增加 2.6% 至港幣 20.4 億元 (2.61 億美元)。受惠於汽車及工業終端市場應用的表現持續強勁，SMT 強勁的銷售收入及新增訂單總額體現於分部強健的表現。集團堅信，其 SMT 於二零二三年第一季度已成功擴大市場佔有率，並佔據了領導地位。

先進封裝（「AP」）

集團擁有業內最全面的先進封裝解決方案，使其得以滿足廣泛應用領域的不同需求。摘要如下：

- **熱壓焊接（「TCB」）**：集團預期未來對其 TCB 設備的需求將繼續保持強勁，部分原因由人工智能應用的演變所帶動。集團亦擴大其全球外判裝嵌及測試商（OSAT）TCB 客戶基礎，向首屈一指的全球晶圓代工客戶交付首批新一代環保、超微間距的晶片與晶圓 TCB 設備。
- **混合焊接（「HB」）**：集團正按計劃向其主要客戶交付用於各種應用的設備。本季度集團已經取得突破性進展，贏得首宗將用於 3D 集成的客戶訂單，並計劃將於明年交付。

前景

在消費信心依然疲弱的宏觀經濟環境下，汽車及工業等行業造好。然而，由於近期銀行業出現動盪，以及通脹持續，全球整體經濟前景仍具不確定性。

基於上述的情況，集團預計二零二三年第二季度的銷售收入將介乎 4.55 億美元至 5.25 億美元之間，以中位數計按年及按季分別減少 26.2%和 2.0%。

長遠而言，憑藉其獨特且廣泛的產品組合，集團對其前景及增長潛力依然保持樂觀，相信長期結構性趨勢，包括汽車電動化、智能工廠、綠色基建、5G、物聯網和生成式人工智能增長所推動的高性能計算，將繼續支持行業的發展。

關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT 是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商。ASMPT 總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及 SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及 LED(顯示板)。ASMPT 與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT 在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數及恒生香港 35 指數之成份股。詳細資訊請查閱 ASMPT 網頁 <https://www.asmpt.com/>。

前瞻聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻聲明。這些前瞻聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，不同因素可能導致實際結果與前瞻聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻聲明，而 ASMPT 不會承擔任何公開地更新或修訂任何前瞻聲明的義務。本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢：

林詒源 (Lim Ee Guan)
企業傳訊總監
電話：+65 6450 1445
電郵：eg.lim@asmpt.com

代表 ASMPT：

縱橫財經公關顧問有限公司
吳燕霞 / 卓愷瑩
電話：2864 4812 / 2114 4979
傳真：2527 1196
電郵：mandy.go@sprg.com.hk / christina.cheuk@sprg.com.hk